

<<手机维修技术基本功>>

图书基本信息

书名：<<手机维修技术基本功>>

13位ISBN编号：9787115217028

10位ISBN编号：7115217025

出版时间：2010-3

出版时间：人民邮电

作者：陈子聪 编

页数：144

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<手机维修技术基本功>>

前言

本书贯彻了教育部对于中等职业教育的改革精神，忠实执行了“以就业为导向”的指导思想，不过多强调学科性，重视技能传授的宏观设计及整体效果，旨在将学生培养成能够在手机的生产、维修技术服务等岗位工作的高素质技能型人才。

本课程是中等职业学校电子技术应用、通信技术、家电维修、电子与信息技术等专业的工程技术专业课。

与同类教材相比，本书主要有以下特点。

(1) 采用项目教学方式的结构编排，一个项目一个(类)知识点，主题鲜明，突出手机维修基本功的训练。

(2) 汇集了多位一线维修人员和一线教师的智慧编写而成，密切结合当前手机维修市场和中职学生的现状，遵循“因材施教”的原则，采用理论和技能训练一体化的编写方式，突出职业特色。

(3) 针对目前中职学生的认知特点，图文并茂，文字表达简洁明了，多采用实物图来讲解，便于学生理解，充分体现了“以学生为本”的教学思想。

(4) 力求真正地体现教师为主导、学生为主体的教学理念，注意培养学生的学习兴趣，并以“成就感”来激发学生学习的积极性。

(5) 设计了许多紧贴实际应用的实训，突出“做中学、做中教”的职业教学特色。如手机整机拆装、手机电路板结构识别、手机主要元器件识别、手机电路元器件手工焊接工艺、手机电路关键点的信号测试、手机指令秘笈的使用、手机软件故障检修仪的使用和手机常见故障检修等，能极大地调动学生的学习积极性，使教与学不再枯燥。

(6) 贯彻国家关于职业资格证书和学业证书并重的政策精神，达到教材内容涵盖手机维修行业职业技能鉴定标准(中级)的知识及技能要求，与当前就业单位“招聘的人能立即上岗”的要求合拍。

<<手机维修技术基本功>>

内容概要

本书密切结合当前手机维修市场和中职学生的现状，以项目教学的方式进行编排，以手机维修基本功的训练为基本特点。

本书内容涵盖了手机的拆装、电路结构、电路原理、主要元器件及电路(板)的识别、常见故障及其维修方法等方面的基本知识和基本技能。

注重理论知识与实践教学环节的有机结合，加强对动手能力的培养，有助于将学生培养成能很好地在手机的生产与维修技术服务等岗位工作的高素质技能型人才。

本书内容新颖、图文并茂、实践性强，既可作为中等职业学校电子技术应用、通信技术、家电维修、电子与信息技术及相关专业的教材，也可作为从事电子技术行业的工程技术人员的参考用书。同时，本书也特别适合作为社会手机培训班的培训教材使用。

<<手机维修技术基本功>>

书籍目录

项目一 手机的拆装与电路板识别 任务一 了解手机外壳结构 任务二 拆装手机外壳 任务三 识别手机电路板 项目二 手机主要元器件的识别 任务一 通用片状元器件的识别 任务二 特别片状元器件的识别 任务三 手机电路外围元器件的识别 项目三 手机电路元器件手工焊接工艺 任务一 了解手工焊接工具 任务二 普通片状元器件的手工焊接工艺 任务三 BGA元件的手工焊接工艺 项目四 初步认识手机电路结构 任务一 初步认识手机整机电路结构 任务二 初步认识手机射频电路结构 任务三 初步认识手机系统逻辑控制电路 任务四 初步认识手机电源电路 项目五 手机电路分析 任务一 手机接收电路分析 任务二 手机发射电路分析 任务三 手机音频电路分析 任务四 手机开机电路分析 任务五 识读手机电路(框)图 项目六 手机电路关键点信号测试 任务一 手机电路关键点信号测试 项目七 手机指令秘笈的使用 任务一 理解手机指令秘笈 任务二 使用指令秘笈维修手机软件故障 项目八 免拆机手机软件故障检修仪的使用 任务一 了解免拆机手机软件故障检修仪 任务二 使用免拆机软件故障检修仪维修手机软件故障 项目九 万用编程器的使用 任务一 了解万用编程器 任务二 使用万用编程器维修手机软件故障 项目十 手机不开机故障的检修 任务一 手机不开机故障的分析 任务二 维修手机不开机故障 项目十一 手机不入网故障的检修 任务一 手机不入网故障的分析 任务二 维修手机不入网故障 项目十二 手机发射故障的检修 任务一 手机发射故障的分析 任务二 维修手机的发射故障 项目十三 手机显示故障的检修 任务一 手机显示故障的分析 任务二 维修手机的显示故障 项目十四 手机卡故障的检修 任务一 手机卡故障的分析 任务二 维修手机的卡故障 项目十五 手机音频故障的检修 任务一 手机音频故障的分析 任务二 维修手机的音频故障 项目十六 手机键盘故障的检修 任务一 手机键盘故障的分析 任务二 维修手机的键盘故障 附录一 手机维修基本知识 附录二 手机维修常见英文术语和缩略词解释 参考文献

章节摘录

二、SOP和QFP封装集成块的手工焊接 (1)用热风枪吹焊SOP和QFP封装的集成块时,可在旁边的元器件上滴几滴酒精,酒精受热时,可以吸去大量的热量,保证旁边的元器件处于安全温度(称为滴水降温法)。

同时,初学者也可先在需要吹焊的集成块四周贴上耐高温的条形纸带,可以避免损坏其周围元器件,吹跑周围小元器件,如图3.8所示。

(2)热风枪喷嘴垂直向下,距集成块2~3cm。不能集中于一点吹,应按顺时针或逆时针的方向,沿集成块引脚均匀转动手柄。温度不要超过350℃,以免吹鼓、吹裂元器件。

(3)拆焊时,在集成块的表面和引脚上加少许松香水。首先用热风枪吹一吹集成块的表面,目的是让集成块预热。然后用热风枪均匀、循环吹集成块的引脚,待引脚焊锡全部融化后,用镊子将集成块取下。不可用力硬撬。

<<手机维修技术基本功>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>